

令和7年12月23日

関係各位

(一社) 日本実装技術振興協会  
会 長 嶋田 勇三

第236 定例講演会のお知らせ

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。  
さて、日本実装技術振興協会の第236 回定例講演会の内容が決まりましたのでお知らせいたします。  
今回は会場とWEB会議システム（Zoom ウェビナー）を利用したハイブリッド開催となります。  
ご多忙の中恐縮ではございますが、万障お繰り合わせの上、ご参加下さいますようお願い申し上げます。ホームページでも同定例講演会の情報を配信します。

敬具

記

1. 開催日時：令和8年1月22日（木）定例講演会 13：00～16：30  
技術交流会 16：45～17：45
2. 開催方式：ハイブリッド方式  
【川崎市産業振興会館2階「カフェサウダージ」＋WEB会議システム「Zoom ウェビナー」】  
（Zoom参加を申し込みされた方には後日、招待メールをお送りします）  
川崎市産業振興会館：神奈川県川崎市幸区堀川町66番地20  
<https://kawasaki-sanshinkaikan.jp/>
3. プログラム：“AI時代を支える半導体実装技術を探る”

(1) 13:00～14:00 プログラムテーマ①	『CPO向け光コネクタの動向とエコシステムの課題』 センコーアドバンス(株) オプティカルコミュニケーションズ事業本部 浅地 佑豪 氏 講演内容：本講演では、AI やデータセンターの急速な発展に伴い進化する光コネクタ技術、特にCPO 向けの最新動向について解説する。精密なアライメントやパッケージング、テストプロセスなどのCPO の技術的課題に対し、同社独自技術による解決策を提案。最新市場動向から技術革新、エコシステムの連携まで、幅広い視点で理解を深められる内容となっている。
(2) 14:00～15:00 プログラムテーマ②	『半導体実装を支えるモールドイング技術の変遷と進化—AI時代を支える先端パッケージの最前線—』 TOWA(株) 市場開発部市場戦略課グループリーダー 家治川 祐一 氏 講演内容：半導体の微細化が限界に近づく中で、前工程だけでは性能向上を維持することが難しくなり、後工程の役割が急速に高まっている。本講演では、パッケージ大型化・高密度化・チップレット化が進む現場で、封止技術がどのように製品性能や歩留りを左右する段階に入っているかを解説する。同社が長年磨いてきたモールドイング技術は、反り制御、均一な樹脂供給、大型チップのMUF 対応など、先端パッケージに不可欠な要素へと進化してきた。本講演では、こうした技術変遷と最新動向を、AI時代の実装現場で求められる視点からわかりやすく紹介する。
15:00～15:30	— 休 憩 —
(3) 15:30～16:30 プログラムテーマ③	『AI半導体におけるパッケージ材料について』 ナミックス(株) 技術開発本部 商品技術ユニット シニアグループマネージャー 阿部 如成 氏 講演内容：大型化・多層化する AI 半導体パッケージ向けの液状材料の現状を説明する。材料に要求される特性と問題点やその解決策などについても言及する。
16:45～17:45	— 技 術 交 流 会 — 産業振興会館2階「カフェサウダージ」にて

4. 参加費  
会 員：無料 企業正会員は1社3名まで（Web会議特例：3名を超える参加者については事務局に問い合わせください）。また、同じ名前とメールアドレスで複数人の方が入室した場合、システ

ム上、同一人物が入室した人数分表示されます。1 登録 1 名様のご利用でお申込みください。  
会員外：22000 円／人（不課税）（お申し込み後、請求書をお送りします）

## 5. 参加申し込み

会 員：会員は別途メールでお送りしているご出欠連絡用紙（企業正会員には登録代表者（連絡担当者）にお送りしています）にご記入の上、E-mail にてお申し込みいただけますようお願いいたします。

※今回、会場と Zoom ウェビナーのハイブリッド方式での開催となります。お申し込みの際は、参加者それぞれ、どちらの方式での参加をご希望か記載してください。

会員外：ホームページのお問い合わせフォーム（<https://www.j-jisso.org/p/contact.html>）より「お問い合わせ内容」の項目に「第 236 回定例講演会参加希望」と参加方式（会場もしくは Zoom）をご記載下さい。参加申込者と参加者が異なる場合、参加者のお名前と E-mail アドレスもご記入ください。お申し込み後、折り返しご連絡をいたします。

申込締切日：会 員 令和 8 年 1 月 13 日（火）

会員外 令和 8 年 1 月 13 日（火）

※講演 2 日前までに、ご参加者各人に招待メールをお送りしますので、ご参加者全員の氏名・メールアドレスをご連絡ください。また、Zoom ウェビナーに参加される際には、ご連絡いただきましたメールアドレス・参加者氏名でログインするようにお願いいたします。セキュリティの関係上、名簿と合致しない場合、Zoom 定例講演会から退場していただく場合がございます。参加者が変更する場合はご連絡ください。

※今年度から講演資料は、当会ホームページの会員のページ（<https://www.j-jisso.org/member/>）に講演日までにアップいたします。ID と PW が必要ですので講演日前までにご確認ください（企業正会員は貴社連絡担当者にご確認下さい）。今年度より資料の郵送はいたしません。

会員外の方はクラウドで資料共有をいたします。

ご不明な点がございましたら下記までお問い合わせ下さいますようお願い致します。

事務局：一般社団法人 日本実装技術振興協会 事務局

URL：<http://www.j-jisso.org>

※HP 右上の「お問い合わせ」からご連絡下さい